

25 工作特性

表 25-1. 温度特性

特性参数名称	符号	值	单位
工作温度范围	T_A	-40~+85	°C
贮存温度范围	T_S	-65~+150	°C

表 25-2. 热学特性

特性参数名称	符号	值	单位
热阻 (结-环境) ^a	Θ_{JA}	32	°C/W
结温 ^b	T_J	$T_A + (P \cdot \Theta_{JA})$	°C

a: 结-环境的热阻 Θ_{JA} 数值通过封装模拟确定。

b: 芯片功耗是其结温的函数。

表 25-3. ESD 最大额定参数^a

参数名称	最小值	标称值	最大值	单位
V_{ESDHBM}	-	-	2.0	kV
V_{ESDCDM}	-	-	1.0	kV
V_{ESDMM}	-	-	100	V

a: 所有 Stellaris® 均按照 JEDEC 标准进行 ESD 测试。

北京锐鑫同创公司相关信息

技术支持

如果您对文档有所疑问，您可以在办公时间（星期一至星期五上午 8:30~11:50；下午 1:30~5:30）拨打技术支持电话或 E-mail 联系。

北京锐鑫同创是 TI 第三方合作伙伴，专注于 TI Stellaris M3 产品的市场推广、方案设计和技术服务，同时提供开发板、仿真器、编程器等开发工具，公司以“把握市场脉搏，专注技术创新，提供诚信服务，实现共赢发展！”为核心价值理念，为客户提供实时、高效的技术和服务。

电话：010-82418301

传真：010-82418302

Email: support@realsense.com.cn

网站: www.realsense.com.cn

技术论坛: www.hellom3.cn